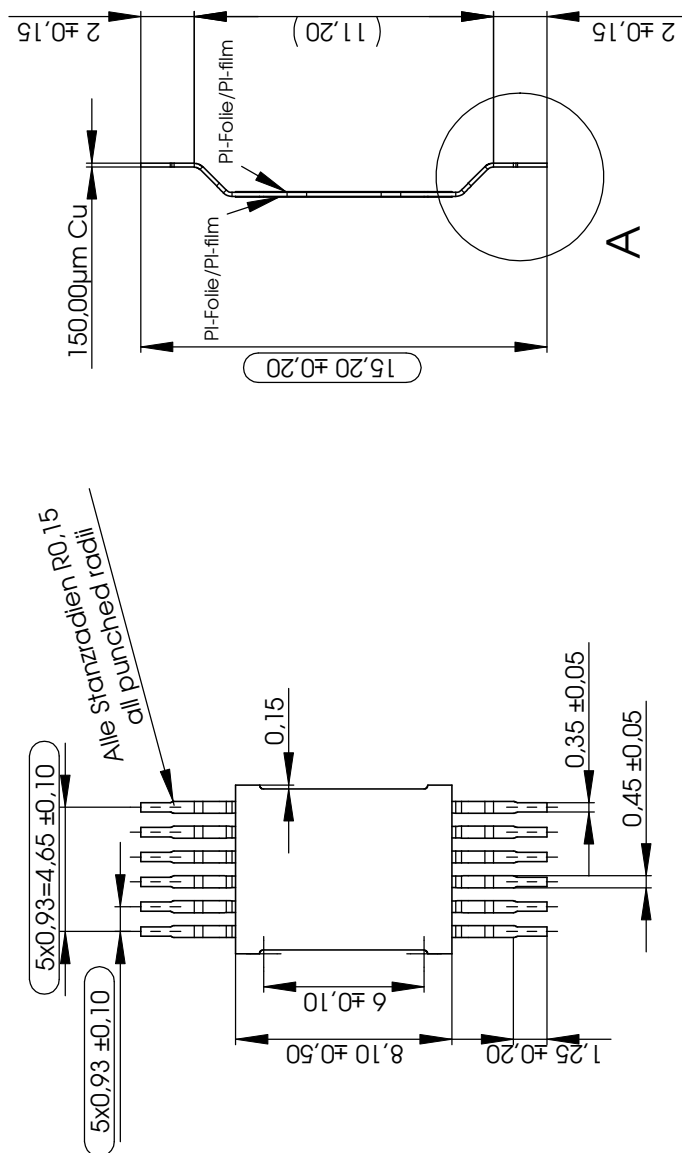
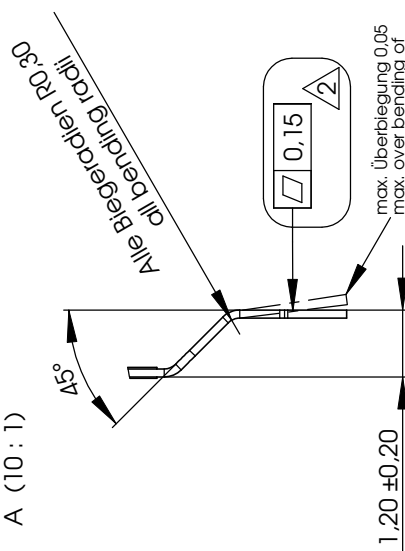
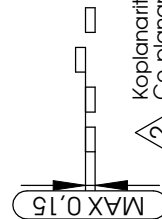




A (10:1)



Die im Anlieferungszustand eventuell auftretende Wölbung passt sich beim Lötvorgang der LP an:
possible warpage in delivery condition will adapt to pcb surface during soldering process.



Koplanarität, für hochstehende Pins
Co-planarity of exposed pins

Maßstab 1:1



Änderungen				
VERSION	ALT	NEU	NAME	DATUM
0		Neuinstellung in SW	Patrick Heine	03.03.2010
1		Zeichnungsänderung nach Erbenummerung	Reif Oswald	21.06.2011
2		Zeichnungsänderungen, Kapalantraf, Pulmase eingetaugt	Patrick Heine	18.06.2012
3		Toleranz angepasst	Patrick Heine	14.11.2012
4		Toleranz angepasst	Patrick Heine	22.11.2012

solutionsmaterial:
 -Öftertemperatur:
 -Gießtemperatur:
 Polzahl:
 Raster:
 -Eitermaterial:
 min. Biegeradius:
 max. Bewegewechsel:
 -Strombelastbarkeit:
 -solutionswiderstand:
 (Leiter-Leiter, Leiter-Folie)
 Koplanarität:
 -Lagerung:
 -Ätbarkeit:
 -Gratbildung:

Polyimid (PI-Folie 25µm + Kleber)
260°C/10s (Reflowfähig)
-40°C bis 125°C

0,93mm
 Cu 150µm±15µm
 verzinkt 8-10µm galv. matt
 DIN EN 13599 , E-Cu58 , EN Cu-ETP , R240
 2mm
 min. 20 mal 135°
 2A nach DIN EN 60512-5-2
 bei min. 300V Prüfspannung >100MOhm
 0,15mm
 Temperatur 10°C bis 40°C
 rel. Luftfeuchte 40% bis 60%
 6 Monate
 DIN 9830 - f

insulation material:
soldering Temperature:
operation temperature:
traces:
pitch:
conductor material:

polyimide (PI-foil 25µm + adhesive)
260°C/10s (reflow soldering)
-40°C to 125°C

conductor material:	copper 150µm ±15µm 8-10µm matte tin plating DIN EN 13599 . E-Cu58 . EN Cu-ETP . R240 2mm
min. bending radius:	min. 20 times 135°
max. bendings:	2A to DIN EN 60512-5-2
current carrying capacity:	at min. 300V test voltage >100MOhm
insulation resistance:	

0,15mm
temperature 10°C bis 40°C
relative humidity 40% to 60%
6 months
DIN 9830 - f

gezeichnet von:	gezeichnet am:	Modell-Nr.:	Formzahl:	Agumentations-DIN ISO 7248:	 sumida Agathe-Zeiss-Str. 5 01454 Radeberg
P. Heine	08.06.2011	5:1	A3	m	
gezeichnet von:	gezeichnet am:	SMD-06-093-K-083-002			
U. Lehmborg	14.06.2011	Sonderzeichnung:			
-	-	Linde:	Zeichnung-Nr.:		
-	-	Unterzeichnende Nr.:	500_26_06_0083_002_4		
-	-	Unterzeichnung-Nr.:			